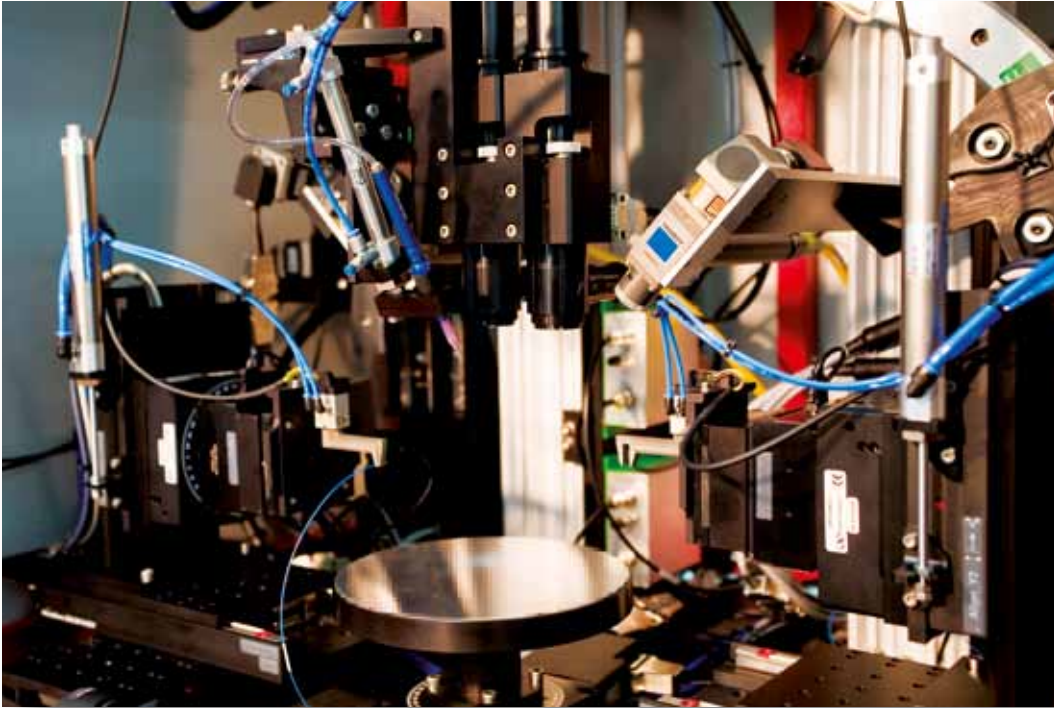


NanoTest

硅光综合测试系统

硅光芯片、器件性能测试与封装



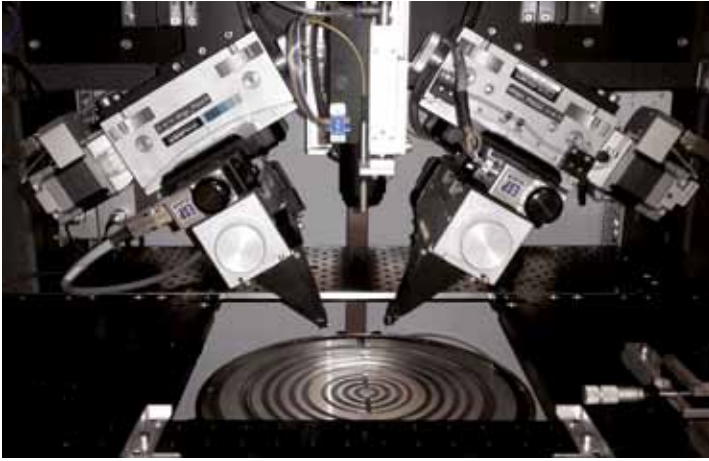
NanoTest 硅光综合测试系统是专门为硅光产品打造的，是理想的wafer 光电测试平台，最大支持 12 寸 wafer。电pin针可手动调节位置，之后可通过wafer 驱动底部的驱动轴实现不同器件的自动切换。

Wafer 载盘可控温 20 至 100° C。

NanoTest 配置了两套 6位耦合驱动轴（亦可选配一套），负责硅光芯片的光-电、光-光性能测试，同时也可兼任器件封装。图像识别摄像头（支持近红外波长）可同时监测两个光探头的具体位置，进行准确的耦合前预定位，软件中的耦合算法可快速找到最佳耦合点。

如果需要封装功能，只需把装载 wafer 的夹具更换为产品夹具，然后在上方加入自动点胶与 UV、或激光焊接、激光焊锡功能既可。上方的耦合轴则可用来夹持（阵列）光纤、（阵列）透镜、光探测器、激光光源等。

- 支持 8 到 12 寸 wafer
- 20 nm 精度耦合
- 0.3 μm 电探针调整精度
- 加热控温
- 可增加器件封装功能



测试时，电探针只需在一开始手动调整一次，之后通过调整wafer底座的XYZ和Yaw 跳转至每一个待测芯片。

nanosystec
PRECISION AUTOMATION

www.nanosystec.com

EUROPE

nanosystec GmbH
Phone: +49 (6078) 782 540
e-mail: europa@nanosystec.com

USA/CANADA

nanosystec Inc.
Phone +1 (919) 345-2010
e-mail: us@nanosystec.com

CHINA

nanosystec Limited
Phone: +86 (0)755-86546974
e-mail: china@nanosystec.com